PCT

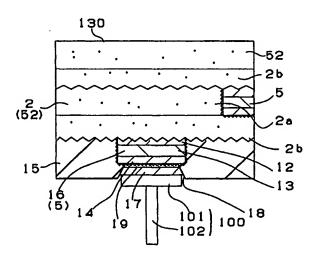
世界知的所有権機関 国際 専 務 局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類7 H05K 1/11		(11) 国際公開番号	WO00/36886
		(43) 国際公開日	2000年6月22日(22.06.00)
(21) 国際出願番号 PCT/JF (22) 国際出願日 1999年11月17日((30) 優先権データ 特願平10/357039 1998年12月16日(16.12.98) 特願平11/34616 1999年1月4日(04.01.99) 特願平11/97648 1999年4月5日(05.04.99) 特願平11/97650 1999年4月5日(05.04.99) 特願平11/04294 1999年4月12日(12.04.99) 特願平11/231931 1999年8月18日(18.08.99) 特願平11/231932 1999年8月18日(18.08.99) 特願平11/231933 1999年8月18日(18.08.99) 特願平11/231934 1999年8月18日(18.08.99) 特願平11/231934 1999年8月18日(18.08.99) (71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) イビデン株式会社(IBIDEN CO., LTD.)[JP/JP] 〒503-0917 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地 Gifu, (JP))	(75) 発明者/出願人(米国に	/IP] P/JP] [JP/JP]

(54) Title: CONDUCTIVE CONNECTING PIN AND PACKAGE BOARD

(54)発明の名称 導電性接続ピン及びパッケージ基板



(57) Abstract

On the board provided with a conductive layer (5), a pad (16) is formed to fix a conductive connecting pin (100) on a package board (310). The conduction connecting pin (100) serves as electrical connection to a motherboard. The pad (16) is coated with an organic-resin insulating layer (15) having an opening section (18) from which the pad (16) is partially exposed. The conductive connecting pin (100) is fixed to the pad exposed from the opening section using a conductive adhesive (17), preventing the conductive connecting pin (100) from separating off the board at the time of mounting.